

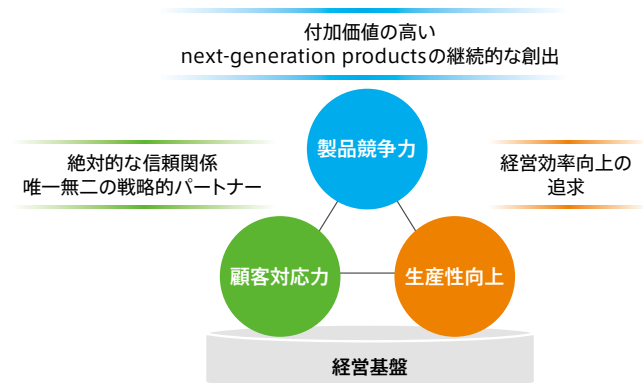
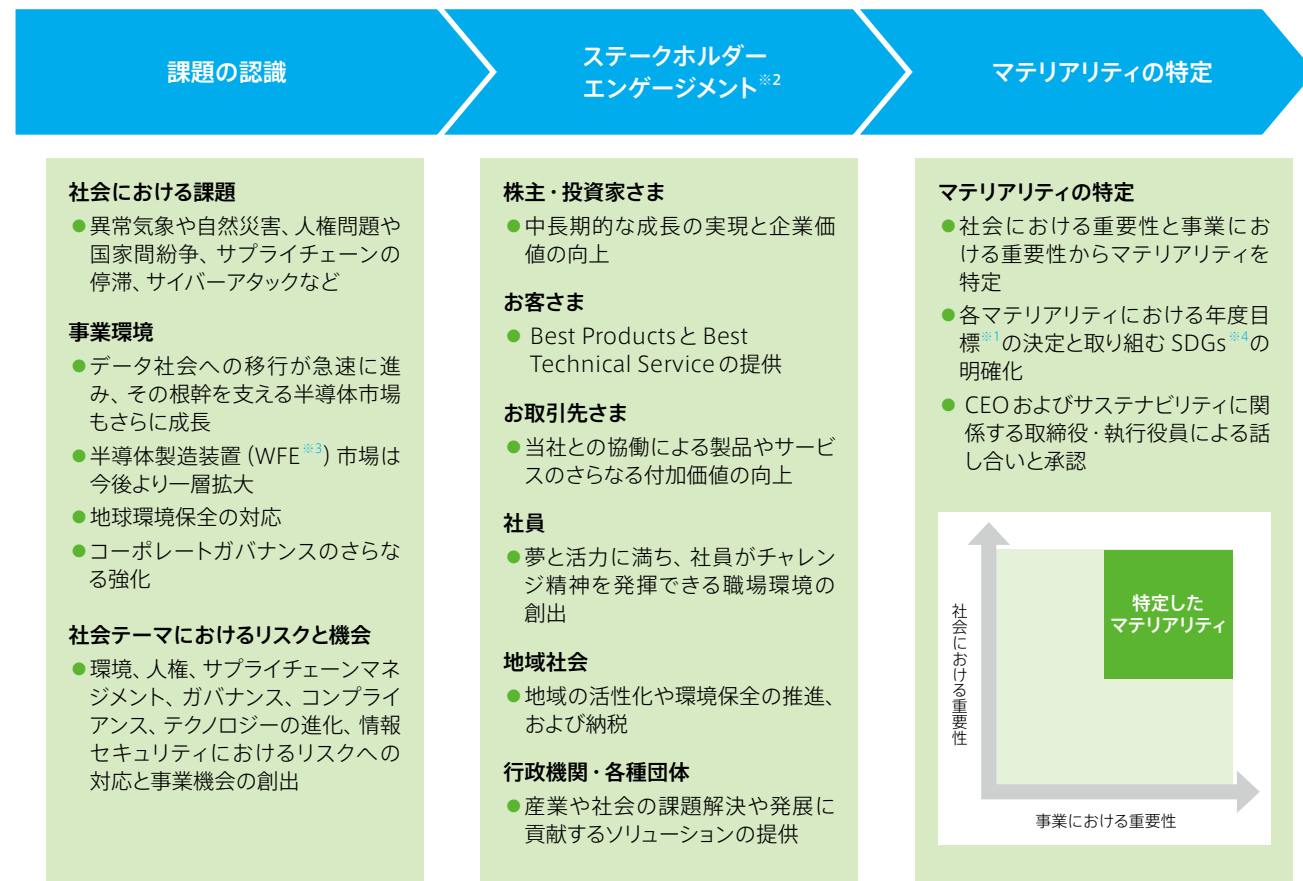
マテリアリティ (重要分野)

マテリアリティの特定

当社は、社会における課題や事業環境の把握、リスクと機会の検討、ステークホルダーの皆さまからのご意見やご要望の整理をおこない、CEO およびサステナビリティに関係する取締役・執行役員の承認のもと、マテリアリティを特定しています。

メーカーである当社の成長を牽引し、将来お客さまが必要とする付加価値の高い next-generation products を継続的に創出する「製品競争力」、唯一無二の戦略的パートナーとして、お客さまとの絶対的な信頼関係のもと半導体の技術革新を追求するための「顧客対応力」、事業規模が飛躍的に拡大する中、研究開発、調達・製造、販売、据付・保守サービスなどのあらゆる事業活動において経営効率を追求する「生産性向上」にそれぞれ取り組むとともに、利益に基づく強い財務基盤のもと、これ

らを支えるガバナンス、コンプライアンス、リスクマネジメントおよび社員エンゲージメントなど「経営基盤」の充実を図っていきます。

マテリアリティの特定プロセス^{※1}

※1 マテリアリティの特定プロセスの詳細は「東京エレクトロン サステナビリティレポート 2022」の「マテリアリティの特定」、年度目標の詳細は「サステナビリティ年度目標と実績」参照
www.tel.co.jp/sustainability/report/

※2 P. 25 ステークホルダーエンゲージメント 参照

※3 WFE: Wafer Fab Equipment. 半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程がある。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置のこと。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含む

※4 SDGs: Sustainable Development Goals. 持続可能な開発目標

	主な取り組み	SDGs への取り組み
製品競争力	- 業界のリーディングカンパニーとして育んだ豊かな技術力を生かし、革新的な技術に基づく付加価値の高い next-generation products をタイムリーかつ継続的に創出 - 技術革新の要請に応えるべく、お客さまと複数世代にわたる技術ロードマップを共創し、また世界屈指のコンソーシアムやアカデミアとの協業により、最先端の研究開発をグローバルに推進 - データや AI を活用したデジタルトランスフォーメーションの推進による開発力および製品競争力の強化	9 産業と雇用 13 気候変動 17 パートナーシップ - イノベーションの促進により革新的な技術を生み出す - 環境に配慮した製品やサービスを提供することで、サステナブルな社会の構築に寄与
顧客対応力	- お客さまのご要望を的確かつ迅速に把握し、先の世代を見据えた革新的な技術の提供を通じて、最先端の半導体デバイスとディスプレイの製造に貢献 - お客さまにとって唯一無二の戦略的パートナーとなるべく、創業以来、重要な経営テーマとして取り組む顧客満足度のさらなる向上 - 多彩な製品ラインアップを有する半導体製造装置メーカーとして、お客さまの価値創造に寄与する最適なソリューションの提案 - 最先端の AI やデジタル技術、ナレッジマネジメントツールなどを駆使した付加価値の高いサービスの提供により、さまざまな世代の装置の長期安定稼働をサポート	9 産業と雇用 12 つぎの産業 17 パートナーシップ - 最適なソリューションの提案や付加価値の高いサービスの提供 - 安全・環境への配慮などにより、お客さまのイノベーションの創出および価値創造に寄与
生産性向上	- 業務効率化や品質を優先したオペレーションの実践に取り組み、経営効率を継続的に追求 - 業務システムの統合およびデータベース一元化などによりグループ全体で標準化や効率化、自動化を推進 - 技術・市場動向の分析やお客さまの投資計画に基づく綿密な生産計画の立案、また安定的な部材調達の推進による製造オペレーションの最適化と平準化	8 雇用と経済成長 12 つぎの産業 17 パートナーシップ - 生産性の向上を追求し継続的に経営効率を高める - サステナブルな生産消費形態を推進することで、産業や社会の発展に貢献し、経済成長に寄与
経営基盤	- 企業としての継続的な成長を根底で支える強靱で健全な経営基盤の構築 - 経営の意思決定と監督機能を十分に働かせるべく、実効性の高いコーポレートガバナンス体制の構築 - コンプライアンスおよびリスクマネジメントのさらなる強化 - 半導体の技術革新への貢献や、製品や事業所、サプライチェーンにおける取り組みによる地球環境の保全 - 高い倫理観に基づく人権尊重の実践 - 社員の多様性を尊重し、個々の能力が最大限発揮できる、夢と活力に満ちた職場環境の構築	3 気候変動 5 ジェンダー平等 8 雇用と経済成長 10 人権と労働 13 気候変動 16 平和と正義 17 パートナーシップ - 持続的な成長を実現する強固な経営基盤を構築 - 人権尊重の取り組みや環境への配慮、サプライチェーンにおける価値創造などを推進

当社では、2030年までに世界が目指す共通目標である SDGs に対する事業を通じた取り組みをマテリアリティごとに明確にし、グループ全体に展開しています。2022年3月期は17の目標に加え169のターゲット^{※5}について再確認をおこないました。

※5 詳細は「東京エレクトロン サステナビリティレポート 2022」の「SDGs 169のターゲット」参照
www.tel.co.jp/sustainability/report/

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

中期経営計画

前中期経営計画

前中期経営計画の振り返り

当社は、2019年5月に中期経営計画を策定し、2024年3月期までに売上高2兆円、営業利益率30%以上、ROE30%以上という財務モデルを掲げ、その実現に取り組んできました。半導体製造装置 (WFE) 市場が大きく拡大する中、当社の注力分野における事業展開が順調に進捗したことで市場成長をアウトパフォームし、2022年3月期は売上高2兆38億円、営業利益率29.9%、ROE37.2%と過去最高の業績となり、目標とする財務モデルを2年前倒しで達成しました。この主な要因は以下のとおりです。

1. 成長投資の継続

当社は、WFE 市場の調整期において売上高が減少した際も、投資の手綱を緩めることなく継続的に増加させ、過去5年間で約6,000億円の研究開発費を投入することにより、業界をリードする技術革新の維持向上に努めてきました。このことにより、付加価値の高い最先端技術を有する新機能や新製品の開発および市場への投入が進み、新しいビジネスの獲得につながりました。また、継続的に設備投資をおこない、生産能力を計画的に整えていたため、2021年においては当社が取り扱うすべての半導体製造装置のシェアが向上しました。

2. 機動的な事業戦略の遂行

当社の基本戦略は、付加価値の高い Best Products と Best Technical Service を継続的に提供することです。2020年初頭からは、新型コロナウイルス感染症の蔓延によって渡航制限の影響を受けましたが、そのような状況においてもお客さまや海外現地法人との密なコミュニケーションにより、営業活動や装置の立ち上げ、サービスを滞りなく提供することができました。また、日本からの駐在者を増やすとともに、現地のエンジニアのスキルアップに努めることで、現地の対応力を強化しました。社員が環境の変化に柔軟かつ迅速に対応しそのチャレンジ精神を十分に発揮することで、お客さまとの信頼関係を強固なものにし、業績の向上に寄与しました。

前中期経営計画に対する進捗

	財務モデル (～ 2024年3月期)				2022年 3月期 実績
売上高	1.5兆円	1.7兆円	2兆円	➡	2兆38億円
営業利益率	26.5%	28%	>30%		29.9%
ROE	>30%				37.2%

3. パートナー企業さまとの密なコミュニケーションと協業

2021年には、WFE 市場が前年比約40%増加と大きく成長した一方、世界的な部材の調達不足が生じました。そのような中、当社はパートナー企業さまへ継続的かつ定期的に情報提供をおこなうことにより、協力体制を構築して部材の調達を円滑に進めることで生産量が増加し、業績は市場成長を大きく上回りました。

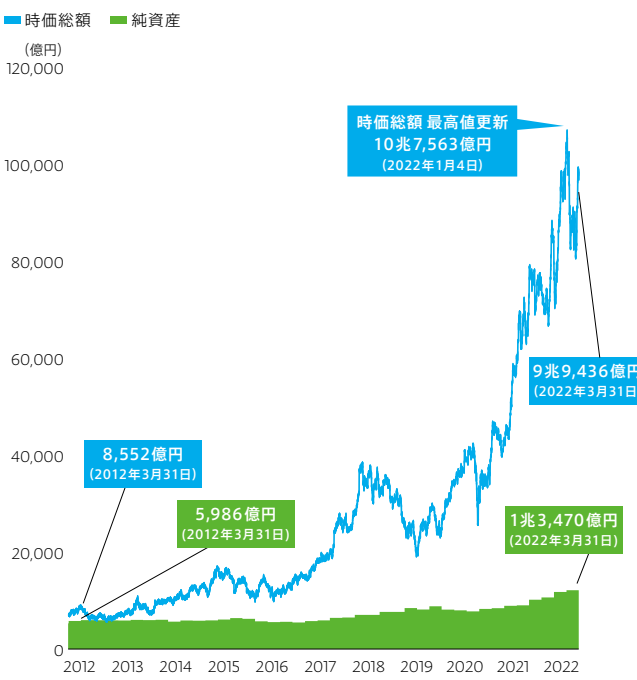
時価総額

当社の時価総額は前述のような業績の向上を背景に、過去10年で10倍以上の増加となりました。

研究開発や生産能力の増強など近年における当社の積極的な成長投資に加え、優秀な人材の確保、お客さまやお取引先さまとの協業などバランスシート上には表現されない価値が株式市場に評価された結果、純資産と比較して時価総額が大きく増加しました。

今後も株主価値および企業価値の向上を目指し、積極的な成長投資を継続していきます。

時価総額と純資産の推移



新中期経営計画

当社は2022年に節目となる第60期を迎えさらなる成長を目指すにあたり、新たなビジョンとともに新中期経営計画を策定しました。これからも Best Products、Best Technical Service を常に追求し、短期および中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を目指していきます。

財務目標と主な取り組み

2027年3月期までに売上高3兆円以上の規模で、営業利益率35%以上、ROE30%以上を達成するという財務目標を設定しました。ワールドクラスの利益の創出を目指し、強靱な財務体質の構築に努めていきます。

財務目標

財務目標 (～2027年3月期)	
売上高	3兆円以上
営業利益率	35%以上
ROE	30%以上

新中期経営計画の達成を目指すにあたり、「製品競争力」「顧客対応力」「生産性向上」「経営基盤」のマテリアリティを軸として以下の取り組みを推進していきます。

- 高付加価値の最先端技術を有する製品と最良の技術サービスを提供
- 今後の成長機会を最大限取り込むために積極的な成長投資を継続し、5年間で1兆円以上の研究開発費を投入
- 業界最大の出荷実績を生かしたフィールドソリューション事業の強化
- データ、AIを活用した生産性および付加価値の向上
- 業界における持続可能なサプライチェーン構築に向けて E-COMPASS^{※1}を推進
- 2050年に向けた長期環境目標を改定し、温室効果ガス排出量を実質ゼロにする「ネットゼロ」を宣言するとともに、目標達成に向けた活動を展開
- 継続的な企業価値の向上に関する重要指標^{※2}の明確化

※1 P. 41 E-COMPASS 参照

※2 P. 17 継続的な企業価値の向上に関する重要指標 参照

コーポレートガバナンス

前述の主な取り組みの遂行においては、経営基盤として実効性の高いコーポレートガバナンスを確実に展開することが重要です。その一環として、当社は2022年6月にコーポレートオフィサー制度を導入しました。CEOを含むコーポレートオフィサーは、執行側の最高意思決定機関として位置づけているコーポレートオフィサーズ・ミーティングにおいて、CEOと同じ視座による意見交換や議論を展開し、重要な意思決定を迅速におこないます。また、コーポレートオフィサーが各責任部門において重要決定事項を速やかに共有するとともに、より強い連携のもと機動的でダイナミックな業務執行を実現します。

本制度により、執行側の体制を強化し取締役会から業務執行側に適切に権限委譲をすることで、取締役会における監督機能の強化を図り、より重要性の高い中長期的な経営課題と成長戦略などについての深い議論を実施する体制を整えます。

資本政策と株主還元策

資本効率についての考え方

当社の資本政策は、成長投資に必要な資金を確保し、積極的な株主還元継続的に取り組み、中長期的な成長の視点をもって、適切なバランスシート・マネジメントに努めることを基本としています。具体的には、営業利益率と資産効率をさらに高め、キャッシュ・フローの拡大に努めることで、持続的な成長を目指し、ROE 向上など高い資本効率を追求します。

株主還元についての考え方[※]

当社の配当政策は、業績連動型を基本とし、親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向50%を目処とします。ただし、1株当たりの年間配当金は150円を下回らないこととします。また、自己株式の取得については、機動的に実施を検討することとしています。

※ 2期連続で当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討

継続的な企業価値の向上に関する重要指標

新中期経営計画において継続的な企業価値の向上に関する重要指標を明確にし、各指標における責任者のもと達成に向けたさまざまな活動を展開しています。

対象分野		指標	達成時期
財務		・売上高: 3兆円以上	2027年3月期
		・営業利益率: 35% 以上	2027年3月期
		・ROE: 30% 以上	2027年3月期
研究開発		・5年間で1兆円以上の研究開発費の投入による付加価値の高いnext-generation productsの継続的な創出	2027年3月期
環境	事業所	・CO ₂ 総排出量: 70%削減 (2019年3月期比)	2031年3月期
		・再生可能エネルギー使用比率: 100%	2031年3月期
		・各事業所におけるエネルギー使用量 (原単位): 前期比1%削減	每期
		・各事業所における水使用量 (原単位): 各基準期水準を維持	每期
	物流	・モーダルシフトおよび共同配送のさらなる推進による物流全体 (自社配送分) のCO ₂ 排出量: 10%削減	2027年3月期
		・製品の梱包材の木材使用量: 50%削減 (半導体製造装置の梱包)	2024年3月期
	製品	・ウェーハ1枚当たりの CO ₂ 排出量: 30%削減 (2019年3月期比)	2031年3月期
社員	エンゲージメント	・エンゲージメント・サーベイのスコア: さらなる改善 (前回比)、またはベンチマークをアウトパフォーム	毎回
		・社員の定着率※ 日本: 99%、海外: 業界平均以上 ※ 定年などによる退職は除く	每期
	キャリア	・一人ひとりが上長や周囲のサポートを実感し、自分の将来 (キャリアパス) をイメージしながらやりたいことにチャレンジし成長することで、会社の成長や社会のために価値創出できる環境を構築 (詳細は P. 47 社員は価値創出の源泉 参照)	2027年3月期
	ワーク・ライフ・バランス	・有給休暇取得率 日本: ①80% / ②90%、海外: 前期実績と同等以上	日本: ①2027年3月期 / ②2031年3月期 海外: 每期
	ダイバーシティ & インクルージョン	・女性管理職比率 日本: 5%、グローバル: 8%	2027年3月期
サプライチェーンマネジメント		・サプライチェーンサステナビリティアセスメントの実施率 資材系: 調達額の85%以上 物流系: 通関関連業者100% 人材系: 派遣会社および請負会社 (構内請負) 100%	每期
		・サプライチェーン BCPアセスメントの実施率 資材系: 調達額の85%以上	每期
安全		・TCIR※ 0.10以下 (業界グローバル1位) ※ TCIR: Total Case Incident Rate。労働時間20万時間当たりの人身事故発生率	2027年3月期

対象分野	指標	達成時期
コーポレートガバナンス	- 常に最適で実効性の高い取締役会と攻めの経営執行体制を構築し、取締役会の実効性評価や機関投資家などからの意見を踏まえた課題に継続的に取り組むことで、中長期的な企業価値向上と持続的成長に向けた強固なガバナンスを実現 1. 実効性の高い取締役会を目指して - 監査役会設置会社: 社外取締役比率1/3 (女性2名)、監査役を含めた自由闊達な議論 - オフサイトミーティング: 中長期的な戦略・課題などの議論 (年2回) - CEO 報告: 取締役会で CEO 自ら重要な業務執行状況を報告 (毎取締役会) - CEO ミッション: 新中期経営計画達成に向けた CEO ミッションの共有 - 代表取締役評価クローズドセッション: 代表取締役を除く取締役・監査役によるセッション (年1回) 2. 業務執行を支えるオペレーティングリズム - コーポレートオフィサーズ・ミーティング: 執行側の最高意思決定機関 (月1回) - CSS (Corporate Senior Staff): 全社業務執行のグローバル横串の連携 (年4回) - 四半期レビュー会議: 新中期経営計画の進捗をモニタリング (年4回)	每期
リスクマネジメント	- 強固な経営基盤を支える実効性の高いリスクマネジメント体制の構築とさらなる改善 「Safety, Quality and Compliance. Our top priority. It's our pride.」の標語を掲げ、リスクマネジメントおよびコンプライアンス遵守を強化 - 本社コンプライアンス専任部署やチーフ・コンプライアンス・オフィサー、リージョナル・コンプライアンス・コントローラーを設置するとともに外部機関によるアセスメントの実施や教育を展開 - 執行側の最高意思決定機関であるコーポレートオフィサーズ・ミーティング、および取締役会への報告 (年2回)を通じて監督・モニタリングを実施 - 当社グループ全体において適切な対策を確実に実施するため、リスクマネジメント委員会を中心に事業を遂行する上で想定されるリスク (2023年3月期は13項目のリスク) を特定し、各社の活動に展開 - 安全・コンプライアンス・リスクマネジメントに関する啓発活動を継続的に実施し、全役員・全社員一人ひとりの意識、および自律的かつ具体的な取り組みを人事評価に反映	每期

半導体製造装置事業の特徴

半導体の技術革新が製造装置市場の成長を牽引する中、最先端の技術とそれを支えるサービスの提供が不可欠になっています。当社では、以下の半導体製造装置メーカーに求められる要件を踏まえ、新中期経営計画における取り組みを推進していきます。



当社の強みと成長の原動力

当社は、「業界のリーディングカンパニーとして育んだ豊かな技術力」や、「確かな技術サービスに基づくお客さまからの絶対的な信頼」、また「環境変化に柔軟かつ迅速に対応できる社員とそのチャレンジ精神」をさらなる成長の原動力として定

めています。こうした原動力により創出される強みを事業活動に生かすことで、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上に努めています。

強み

Only one

半導体の微細加工に必要な成膜、塗布・現像、エッチング、洗浄という連続した4つのキープロセスに製品をもつ世界で唯一のメーカー

成膜

塗布・現像

エッチング

洗浄

100%

半導体の進化に必要な EUV※1 露光用の塗布・現像装置のシェアが100%

※1 EUV: Extreme Ultraviolet。極端紫外放射 (極紫外放射)。波長1nm~100nmの範囲の紫外放射 (紫外線) のこと

塗布・現像

EUV露光

No.1/No.2

当社の製品群は各セグメントで強いポジションにあり、いずれも市場シェア※2 1位もしくは2位を獲得

※2 当社推定 (2021年)

※3 各セグメントにおける当社の製品群：拡散炉は熱処理成膜、パッチ成膜は ALD (Atomic Layer Deposition)、メタル成膜は枚葉成膜、洗浄は 枚葉洗浄とバッチ洗浄をそれぞれ含む

1位

1位

2位

1位

2位

1位

2位

1位

拡散炉※3

パッチ成膜※3

メタル成膜※3

塗布・現像

プラズマエッチング

ガスクミカルエッチング

洗浄※3

ブローバ

No.1

販売した装置が新たな事業機会となり、価値を生むフィールドソリューションのビジネスモデルを構築

※4 2022年3月31日現在

世界装置出荷台数 (累計) 業界最大の約82,000台※4

年間約 6,000台ずつ増加

成長の原動力

業界のリーディングカンパニーとして育んだ豊かな技術力

お客さまとの共同開発や世界屈指のコンソーシアムとの協業による革新的かつ多様な技術

強固な経営・財務基盤のもと、最先端技術の創出を目指した積極的な研究開発投資

データや AI を活用したデジタルトランスフォーメーションによる製品開発

確かな技術サービスに基づくお客さまからの絶対的な信頼

お客さまと技術ロードマップを共創し、圧倒的な付加価値をもつ次世代製品をいち早く市場に投入

お客さまの唯一無二の戦略的パートナーになるため、顧客満足度の向上と信頼関係の構築に尽力

お客さまの高度化・多様化する技術ニーズに対し、長年の実績に基づく付加価値の高い技術サービスをタイムリーに提供

環境変化に柔軟かつ迅速に対応できる社員とそのチャレンジ精神

社員のやる気を重視した経営を推進し、人材開発の強化とともに社員エンゲージメントの向上に注力

価値観や社員一人ひとりの心構えを行動規範としてまとめた「TEL Values」の実践

定期的なグローバル・エンゲージメント・サーベイの実施による課題の把握と施策の実行

半導体製造装置事業の展望

データ社会への移行が急速に進む中、その根幹を支える半導体は、さらに重要性を増しています。2021年に半導体市場は初めて5,000億米ドルを超えましたが、2030年には1兆米ド

ルを超え、現在の市場の倍以上に成長すると予想されています。これに伴い、2021年の WFE 市場は約900億米ドルとなり、今後もさらに成長していくと見込まれています。

半導体市場

(兆米ドル)

Year	Market Size (T USD)
1990	0.02
2000	0.15
2010	0.25
2020	0.55
2021	5,559 billion
2030	>1 trillion

Source: 1990-2021 (WSTS)、2022-2030 (IBS, May 2022)

WFE 市場

(億米ドル)

Year	Market Size (B USD)
1990	50
2000	350
2010	300
2020	850
2021	900
2030	1,050

Source: TechInsights Manufacturing Analysis Inc. (VLSI) (1990~2021)

半導体デバイステクノロジーの進化と事業機会

半導体市場や WFE 市場のさらなる成長を支えるのは、半導体デバイスにおける技術革新です。ロジック / ファウンドリ、NAND、DRAMの各アプリケーションにおいては、さらなる微細化、高積層化による製造コストの低減や低消費電力化、高速

化への要請が今後も高まることが予想されます。当社は、幅広い製品ラインアップを生かし、競争優位性の高いデバイス製造に貢献します。

半導体デバイスと当社の製品ラインアップ

ロジック: 熱処理成膜

NAND: ALD, 枚葉成膜, コータ / テベロッパ (塗布・現像), プラズマエッチング

DRAM: ガスクミカルエッチング

3Dシステムインテグレーション: 枚葉洗浄, バッチ洗浄

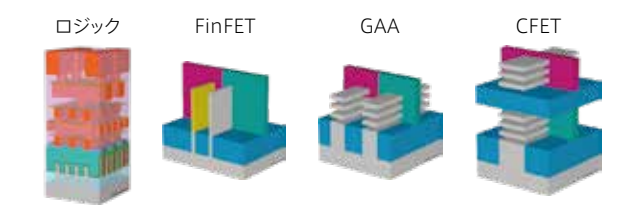
ウェーハボンディング / デボンディング: ウェーハブローバ

19 東京エレクトロン 統合報告書 2022 東京エレクトロン 統合報告書 2022 20

ロジック / ファウンドリ

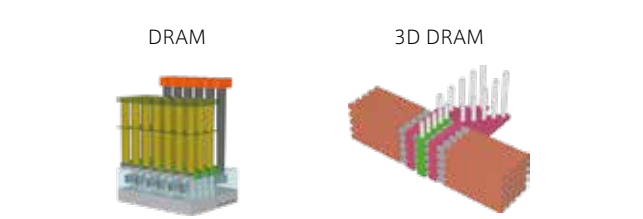
パターンニングが複雑化し、ユニットプロセス間の相互最適化の必要性がますます増大しています。今後、さらなる微細化の実現に向けて高 NA EUV※1リソグラフィ技術の量産への適用が進むと見込まれます。また、この高NA EUVによる微細化のみならず、さまざまな新規技術や構造が導入されていきます。トランジスタ構造においても新しい3次元型の構造 (FinFET※2、GAA※3、CFET※4) へ移行していくことが予想されます。当社の前工程向け装置やウェーハボンディング装置がこのような技術革新の実現に貢献します。

※1 高 NA EUV: 次世代 EUVを指し、NA (Numerical Aperture。開口数) を上げることでより解像できる線幅を短くする露光技術
※2 FinFET: Fin Field Effect Transistor。Fin (ヒレ) 状の3次元構造のプロセス技術
※3 GAA: Gate All Around。FinFETの次世代技術
※4 CFET: Complementary Field Effect Transistor。新構造のトランジスタ



DRAM

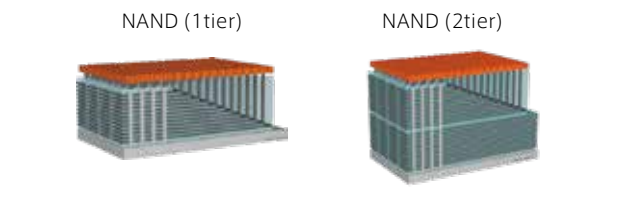
配線による遅延の抑制技術、2次元 (2D) の微細化をさらに進めるための技術などが求められます。DRAMにおけるこの技術には、当社の成膜、エッチング、洗浄装置が多く採用されていますが、さらなる微細化を実現するために、新たな製品やソリューションを継続的に提供していきます。今後は2次元の微細化が進み、さらに3次元 (3D) 構造を採用した3D DRAMへ移行していくと予想されます。3D DRAMにおいては、NANDが2Dから3Dに移行した際と同じように、リソグラフィによる2次元的な微細化に代わり、縦方向への積層化がスケーリングを牽引します。このため、特に、成膜、エッチングのプロセスにおける重要性が増すことが見込まれます。



NAND

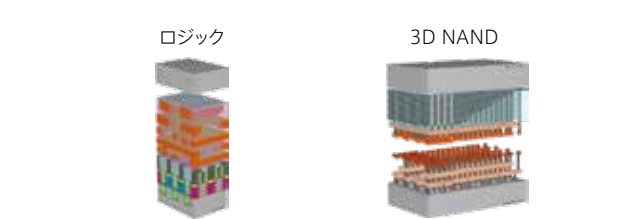
3D NANDの積層化がさらに進み、今後300層、500層と積層数が増加します。これに伴い、高アスペクト比※5の深い穴や溝の加工を実現するエッチング、高生産性の犠牲膜除去、3次元構造における原子レベルの成膜技術などが必要となります。また、積層数の増加に伴うチップ製造コストの増加を抑制するための工程統合が求められます。当社は、これらの技術要求に応えるべく、エッチング装置や ALD 成膜装置のさらなる高性能化に努めています。

※5 アスペクト比: ウェーハ上に形成されたパターンの深さと幅の比



3D システムインテグレーション

半導体デバイスの性能向上へ向けて、ウェーハボンディング技術を用いた3次元でのシステムインテグレーションが進展しています。CMOS イメージセンサーにおいては量産適用が進んでおり、同技術を用いた3D NANDでのメモリセルと駆動回路の貼り合わせや、ロジックにおける裏面配線の開発も加速しています。また先端実装技術として、Chipletと呼ばれる個片化されたチップをボンディングする技術が注目されており、デバイスの高速化と低消費電力化、そして低コスト化が期待されています。当社は前工程で培った技術と経験を生かし、ウェーハボンディング装置やレーザトリミング装置の提供により、最先端デバイスやシステムレベルでの性能進化に貢献します。

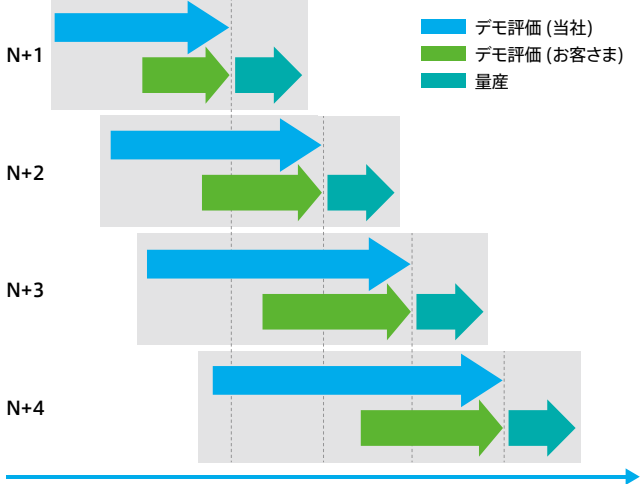


お客さまとの協働による複数世代にわたる開発

微細化の技術的な難易度が増す中、最先端のメモリおよびロジック / ファウンドリにおいては、量産世代である N 世代の評価に加え、N+1から N+4の開発が同時に進められています。半導体メーカーとこのような開発・評価を継続するためには、高い技術開発力とエンジニアリングにおけるリソース、そして強い財務基盤が求められます。

当社は、お客さまである半導体メーカーとそれぞれの役割を担いながら長期の技術ロードマップを共創し、4世代先までの技術の開発と評価をおこなっています。お客さまが製造工程で実際に使用しているウェーハを用いて評価をおこなうことで、装置性能およびプロセスパフォーマンスを早期に実証しています。このような取り組みにより、高い付加価値をもつ製品を確実に創出し、新たなビジネス機会の獲得に努めています。

4世代先までの開発と評価



開発体制のさらなる強化

最先端の半導体デバイスにおける4世代先までの開発と評価を進めるため、当社は開発体制をさらに強化しています。

これまで、TEL デジタル デザイン スクエアと宮城技術革新センターを立ち上げていますが、今後山梨、熊本、宮城の3つの事業所で、2023年から2025年の間に新たな開発棟を稼働させ

ることを計画しています。山梨では成膜およびガスケミカルエッチング装置の開発やコーポレート開発を、熊本ではコータ / デベロッパおよび洗浄装置の開発を、宮城ではエッチング装置の開発をそれぞれ担う予定です。



TEL デジタル デザイン スクエア (2020年11月開設)



宮城技術革新センター (2021年10月稼働開始)



山梨 新開発棟 (2023年春竣工予定)



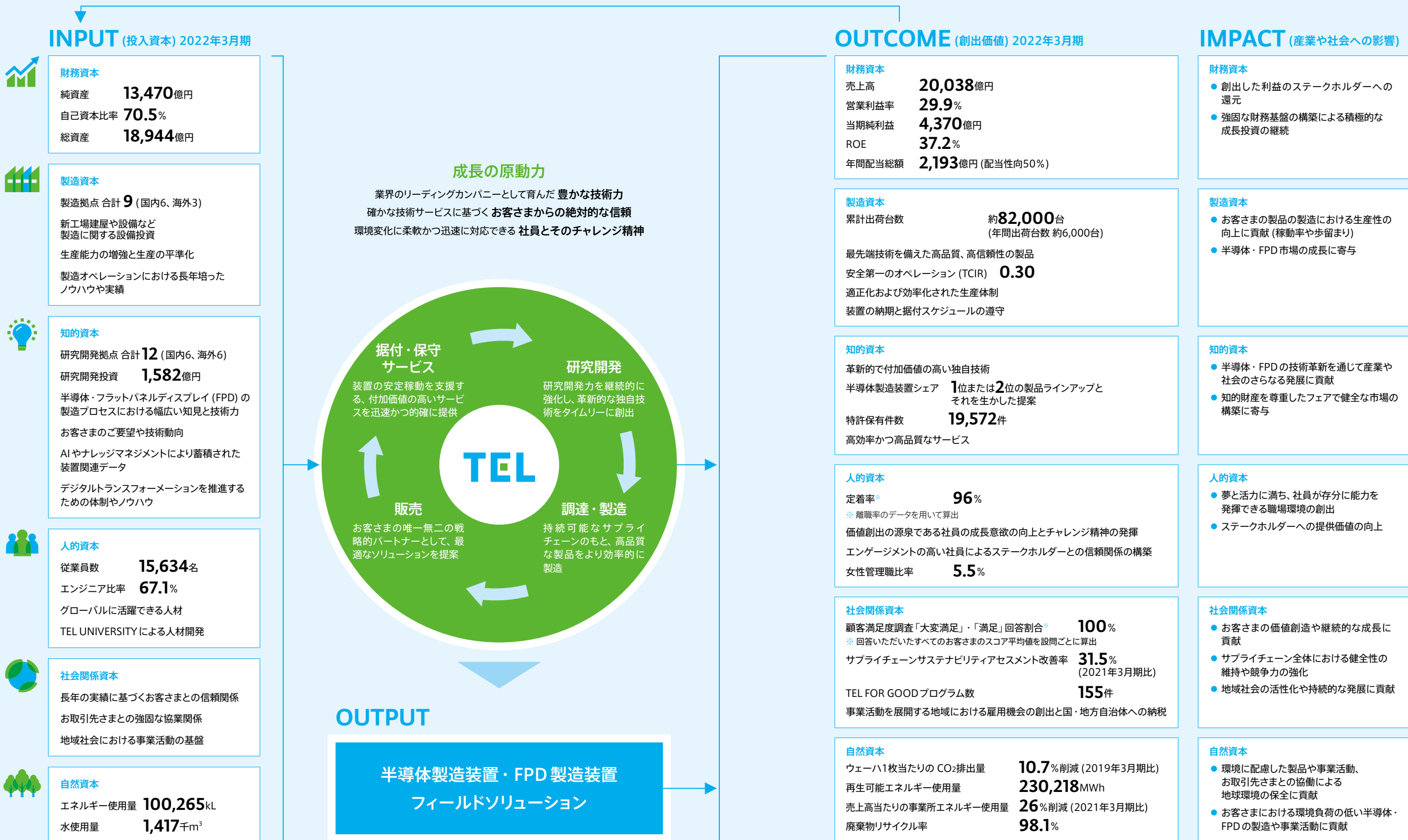
熊本 新開発棟 (2024年秋竣工予定)



宮城 新開発棟 (2025年春竣工予定)

価値創造モデル

当社が有する資本を最大限に生かし、研究開発、調達・製造、販売、据付・保守サービスの事業活動におけるバリューチェーンの展開を通じて、産業や社会の課題解決と発展に貢献する新たな価値を継続的に提供していきます。



ビジョンの実現と基本理念の実践

ステークホルダーエンゲージメント

ステークホルダーとのエンゲージメントの機会を積極的に設け、相互コミュニケーションを推進することにより、要請を的確に把握し、事業活動に反映しています。当社を取り巻くすべてのステークホルダーとの確固たる信頼関係の構築に努め、期待に一つひとつ応えていくことで、社会における役割と責任を果たしていきます。

